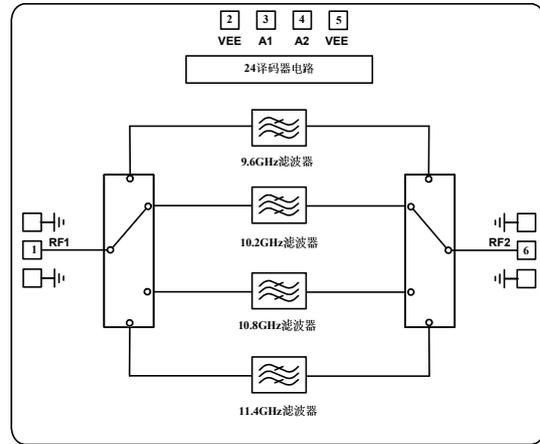




主要特点

- 内部集成 2: 4 译码器
- 通道数目: 4
- 通带频率: 9.6 GHz
10.2 GHz
10.8 GHz
11.4 GHz
- 功耗: -5 V @ 6 mA
- 输入 P-1: 26 dBm
- 芯片尺寸: 3.5 × 4.5 × 0.1 mm³

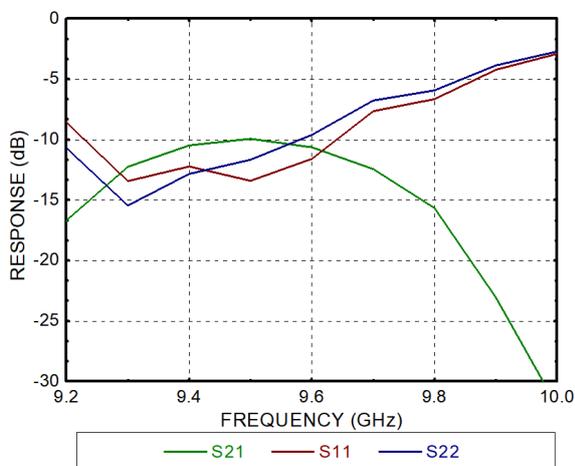
功能框图



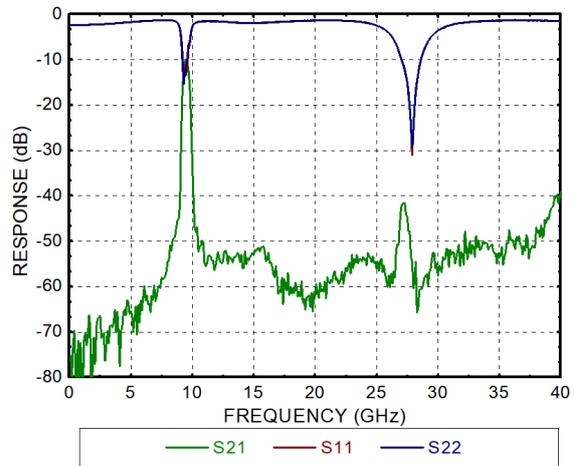
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数名称	通带 1	通带 2	通带 3	通带 4	单位
频率	9.6	10.2	10.8	11.4	GHz
带内损耗	10.5	10	10	11	dB
回波损耗	10	15	15	10	dB
带外抑制	40@9GHz 40@10.2GHz	40@9.6GHz 40@10.8GHz	40@10.2GHz 40@11.4GHz	40@10.8GHz 40@12GHz	dB

9.6GHz反射系数

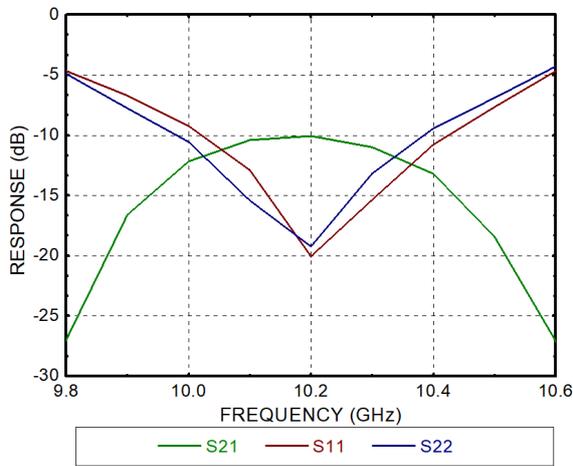


9.6GHz反射系数

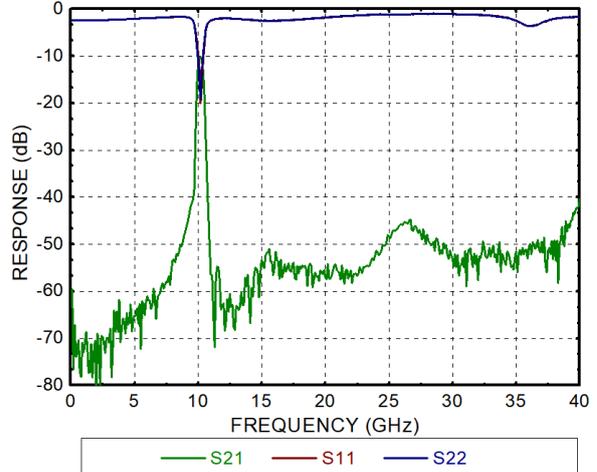




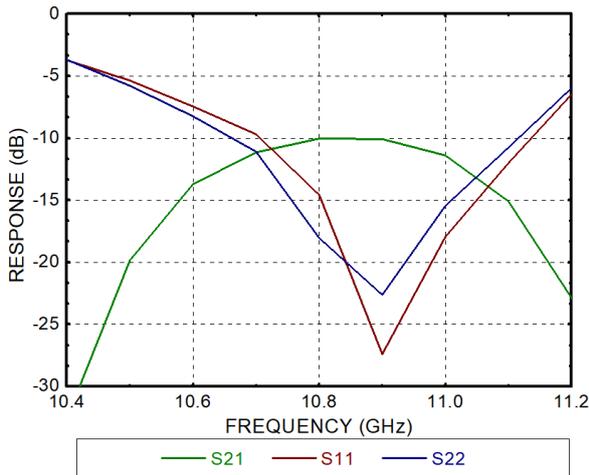
10. 2GHz反射系数



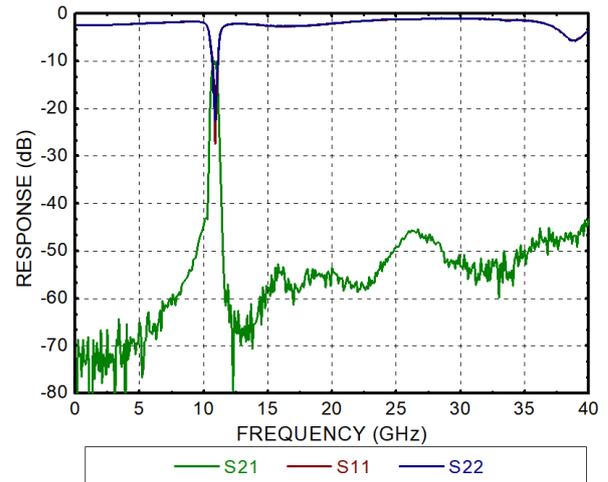
10. 2GHz反射系数



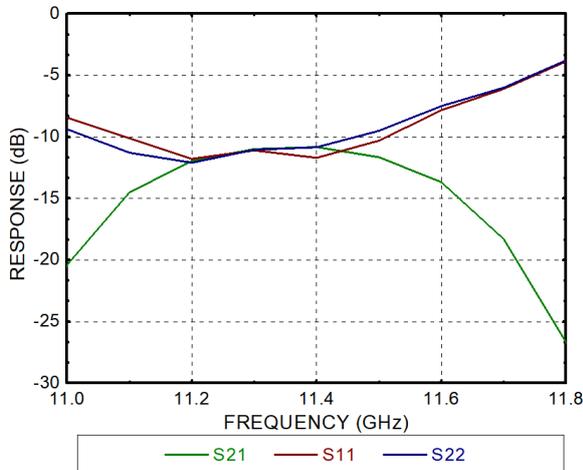
10. 8GHz反射系数



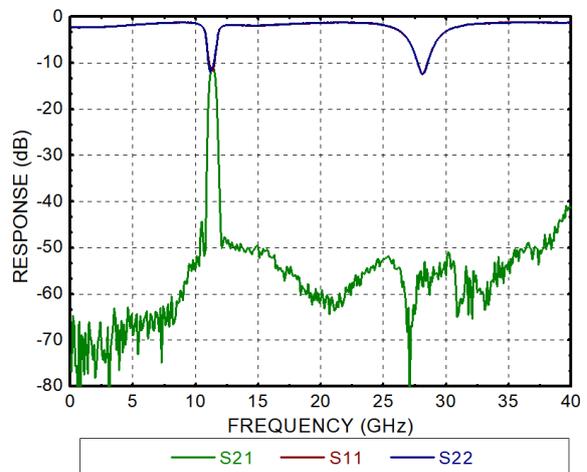
10. 8GHz反射系数



11. 4GHz反射系数

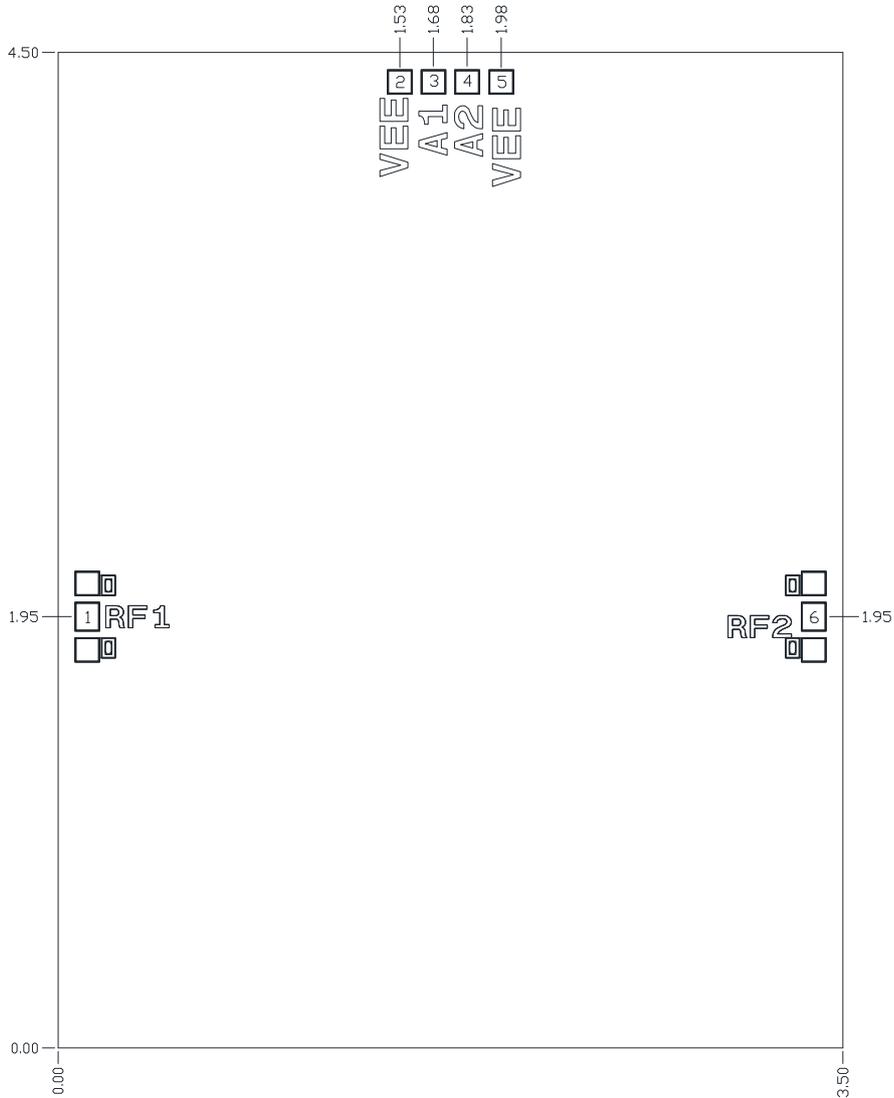


11. 4GHz反射系数





物理参数



焊盘描述

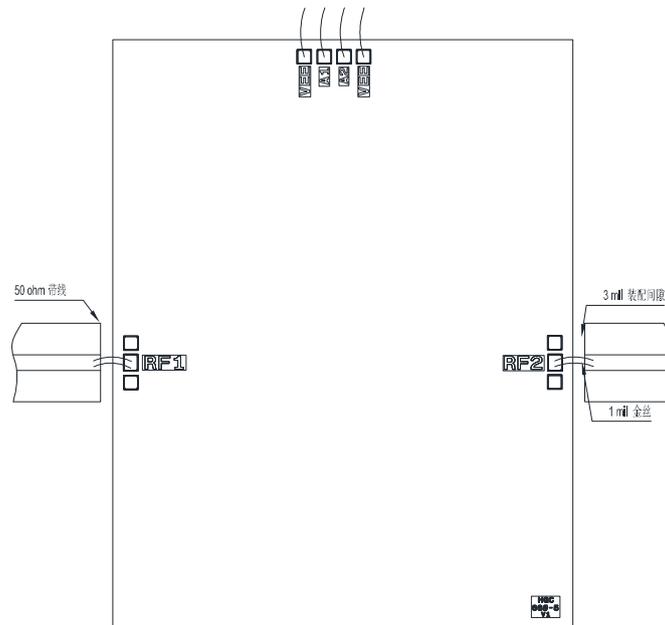
焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
6	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2, 5	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3-4	A1-A2	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

真值表

频率(GHz)	C1	C2
5-13	0	0
5-6.1	0	1
6-7.1	1	0
7-8.1	1	1

“0” 电平范围: 0~0.5V; “1” 电平范围: 3~5V;

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6 μm ，

极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+30 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$